

복합재료에서의 유용자원 회수 공정 개발

조성수*, 이수영, 최강룡, 지재규¹, 신은화¹
고등기술연구원; ¹(주)리사이텍
(sungsu@iae.re.kr*)

국내 포장재는 전자/통신, 식음료, 건설 등에 많이 사용되고 있으며 포장재 용도에 따라 포장재 재질과 형상도 매우 다양하게 제작되어 있는 상황이다. 특히, 전자 및 식음료의 경우 장기간 보존해야 제품의 변색과 품질을 보장할 수 있기 때문에 포장재의 투계와 필름의 선택 등은 매우 중요한 문제로 대두되고 있는 실정이다. 그러나 이러한 포장재는 산소 및 자외선 차단 등 고려하여 제품에 따라 알루미늄 박막의 두께나 수지의 종류가 다르고 폐기되는 포장재는 현재 열적처리에 의존하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 열적처리에 의존하지 않고 물질재활용을 하기 위해 물리적 처리방법을 적용하여 효과적으로 자원을 회수하는 공정을 개발하였다.